

成都华微电子科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将技术创新作为核心驱动力，以管理体系升级为重要依托，通过搭建系统化的组织发展架构，不断夯实自身竞争优势。公司全面落实可持续发展战略，从多方面入手构建长期价值创造机制，依托建立常态化的投资者沟通渠道、健全利润分配制度等手段，切实维护投资者的合法权益。基于对资本市场稳健发展的责任意识，公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），确立了“以客户价值为导向、为股东创造价值、助力员工价值实现、与社会共享价值”的四维价值体系。2026 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下：

一、业务聚焦与研发创新

公司深耕特种集成电路领域，业务覆盖研发、设计、测试及销售全流程，以提供信号处理与控制系统整体解决方案为核心发展方向。立足国家战略需求，公司致力于打造国家级集成电路科研与生产龙头企业，成为推动行业技术进步与产业升级的核心力量，为我国特种集成电路产业的长远发展提供坚实支撑。

2026 年上半年，公司实现营业收入 24,988.04 万元，受行业需求波动影响，订单规模同比有所下降。公司积极应对市场变化，持续推动业务发展。作为技术驱动型企业，公司始终将研发创新视为战略核心。2026 年上半年，公司研发投入强度进一步提升，研发投入合计 13,842.24 万元，同比增加 37.96%，同时研发投入占营业收入比例达到 55.40%，同比增加 27.13 个百分点，充分体现了公司对技术创新的高度重视和持续投入。

截至 2026 年上半年末，公司围绕主营业务方向开展理论研究与技术攻关，在知识产权布局方面，公司在主营业务领域新申请发明专利 10 件、实用新型专利 1 件、软件著作权 3 件，展现出强劲的研发创新能力；同期获得重要知识产权授权：发明专利 6 件、软件著作权 3 件、集成电路布图设计 1 件，并在国内学术期刊发表专业学术论文 2 篇，进一步充实了公司的技术储备。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计获得且有效的发明专利达 139 项、实用新型专利 9 件、集成电路布图设计 217 项，软件著作权 56 项。

公司始终坚持“人才是创新第一资源”的核心理念，将高水平人才队伍建设作为技术创新和可持续发展的战略基石。截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员占比达 42.77%，较去年同期净增加 25 人，公司积极推进高素质、专业化的研发团队，为持续创新提供了坚实的人才保障。

行动方案实施以来，公司已收获明显成效：产品性能指标不

断优化，产品线持续延伸，产品组合日益完善。各主要研发项目的资金投入、当前状态及预期目标情况如下：

序号	项目名称	本期投入金额（万元）	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能FPGA	2,316.41	已形成五百万门到亿门级FPGA谱系化产品；SerDes线速率覆盖6.25Gb/s~32Gb/s；已形成集成高速ADC/DAC的RF-FPGA产品；已形成集成CPU和FPGA的异构PSoC产品；在研2.5亿和4亿门级FPGA产品；在研高端FPGA软件开发工具	集成高速ADC/DAC、CPU和信号处理定制加速单元，实现大带宽信号处理高性能处理平台	国内领先	数据处理、5G通信、卫星通信、人工智能加速等大带宽信号处理计算平台等领域
2	超高速ADC/DAC	3,907.96	已完成10位128GSPS超高速ADC样品研制，正在根据实测结果进行迭代优化设计；已完成10位128GSPS超高速DAC优化设计，开始流片	基于国内先进工艺制程，突破超高速ADC/DAC高采样速率、大带宽、低误码率的性能指标，形成8-16位10-160GSPS超高速ADC/DAC产品	国际先进	通信、雷达探测与对抗等领域
3	零中频射频收发机系列化产品研制	1,548.07	HWD9361根据实测结果已完成优化设计，开始流片；HWD9026正在设计中	面向通信感知、无人机等需求广阔的市场化应用，研究国际现有先进产品替代解决方案，实现零中频射	国内领先	无人机、通信收发机等

				频收发机谱系化产品		
4	智能异构系统 (SoC) 芯片	2,888.00	已成功研制用于边缘计算领域的人工智能芯片, AI 算力高达 16Tops, 已在特种行业的多个客户里小批量试用。更高性能和更高算力的智能异构 SoC 芯片也在研发中	集成 CPU、GPU、NPU 以及 eFPGA 等核心 IP, 实现异构多核协同处理, 形成高效处理标量, 矢量和张量等多种计算的灵活高能效比计算平台	国内领先	机器人、无人机、车载等嵌入式计算平台等领域
5	微控制器芯片 (MCU)	970.73	已形成低功耗、通用、高性能的低中高全系列产品体系, 达到供货阶段; 双核高性能 MCU 已进入测试送样阶段; 正在研制高性能航天用 MCU 产品	形成特种集成电路最完整谱系产品, 高性能计算在微控制器领域应用落地	国内领先	电机控制、车载等嵌入式控制领域
6	电源管理芯片	616.14	已形成快速瞬态响应、超低噪声 LDO 电压调整器和高功率密度高效率 DC-DC 转换器谱系化产品。5A 输出电流产品已经完成设计流片, 正在初样验证; 6A 输出电流产品正在设计开发。高压 DC-DC 转换器 80V-100V, 1A 以下产品正在样品验证; 100V, 2A 产品正在设计过程中。大电流 DC-DC 转换器, 输出电流 26A、36A、50A 产品已进入可靠性验证; 输出电流 100A 产品正在设计过程中。600V 高压驱动控制器已完成设计和流片, 正在样品验证	面向高速通信和高速数据处理大电流 LDO 输出电流达到 5A, 高压 DC-DC 转换器耐压达到 100V, 大电流 DC-DC 转换器输出电流达到 100A, 高压大功率智能驱动控制器输入电压达到 600V	国内领先	高速通信、数据采集、伺服控制、精密测量、光伏、储能、数字能源等领域

7	总线接口芯片	256.40	已形成 245 总线、RS232/422/485 协议、LVDS 等接口谱系化产品；CAN 总线收发器、有源滤波器方向多款典型产品已经定型并小批量供货；正在进行隔离 485 协议芯片研发，隔离电源及数字隔离通道预计年底输出，后续通过 SiP 方式实现隔离协议接口	开发 35KV 高等级 ESD 结构、宽电源域输入端口、高数据率驱动器等设计，形成功能全面、应用灵活的接口产品库	国内领先	信号传输、通信系统、计算机系统等领域
8	高精度数据转换 (AD C/D AC) 芯片	933.23	已完成一款 32 位隔离 ADC 和一款超低噪声并带有低漂移电压基准的单通道 ADC 研制，正在进行更高采样率、更低噪声电压和集成可变增益放大器、可编程采样率和空间高可靠性设计等方面的产品扩展设计，目前处于电路设计中	集成高阶调制器、可编程增益放大器、高精度基准源等可复用核心电路，形成精度高、采样率和输入范围可配置的通用 AD 转换器产品	国内领先	工业控制、陀螺、加速度计、热电偶、环境探测等领域
9	应用验证及其他	344.58	已形成飞控板、电机控制板、地检测试设备等板级产品，形成近十款可供货高可靠性信号处理 SiP 产品。在存储器芯片方面 DDR3、DDR4、1G nor Flash、eMMC 32Gb，已达到供货阶段，在研的大容量 eMMC 已进入正样阶段	形成特种集成电路信号处理 SiP、系统板卡以及控制电路 SiP、系统板卡的核心供应商；形成特殊集成电路通用存储器产品，并辅助 SiP 类产品开发研制以及应用	国内一流	特种行业电子系统化、小型化，高可靠性应用；覆盖特种集成电路行业高算力系统应用中的存储器

二、募投项目实施与推进

2024 年 2 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募

集资金总额约为人民币 15 亿元。公司系统推进募投项目全生命周期管理，构建“规划-实施-监控-优化”的闭环管理体系，严格遵循募集资金的管理要求，谨慎合理地使用资金，确保募投项目按照既定规划稳步开展。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目累计投入 86,727.41 万元（未包含补充流动资金项目部分），2026 年上半年共投入 3,670.53 万元，累计投资进度为 66.71%。

针对“芯片研发及产业化”项目，2026 年上半年投入金额 2,944.84 万元，累计投资进度为 54.03%。公司将继续就高性能 FPGA、高速高精度 ADC、自适应智能 SoC 等三个方向的产品研发进行持续投入，尽早完成产品研发并实现产业化。“高端集成电路研发及产业基地”项目，2026 年上半年投入金额 725.69 万元，累计投资进度为 84.00%。该项目的实施将助力公司打造集设计、测试、应用开发为一体的高端集成电路产业平台，强化巩固公司在特种集成电路领域的核心地位。

三、注重投资者回报与稳固预期信心

公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格遵循相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的有关规定。公司已于 2026 年 7 月 15 日发放了 2025 年度现金红利，每 10 股派发现金红利 0.49 元人民币（含税），以公司总股本 636,847,026 股为基数，共计派发现金红利 31,205,504.27 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 20.32%。

公司自上市以来已累计现金分红 115,269,311.71 元(含税),持续通过现金分红等方式积极回馈投资者,切实履行了上市公司责任与义务。

后续公司将在充分考虑行业属性和自身发展阶段的基础上,努力在资本支出、经营性资金需求与现金分红三者之间找到合理平衡点,既保障公司稳健运营,又回应投资者的合理收益诉求。在遵守相关法律法规及《成都华微电子科技股份有限公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》等制度的前提下,结合公司战略规划、经营业绩和财务健康状况,适时、合理地调整分红水平和分配方式,逐步搭建起长期、稳定、连贯的分红制度安排,确保投资者能够及时、公正地分享企业发展成果,实现公司与投资者的双向共赢,促进公司可持续、高质量发展。

四、优化公司治理体系以保障长期发展

在公司运营管理体系中,“关键少数”发挥着决定性作用。公司始终将提升“关键少数”的履职能力作为增强企业竞争力的重要抓手。

在培训机制上,公司积极搭建多渠道学习平台,鼓励董事及高管参加监管机构组织的各类培训。当监管政策出现重大调整时,公司会第一时间组织专项培训,帮助“关键少数”准确把握证券市场相关法律法规的最新要求,紧跟监管走向,确保各项决策在合规性和专业性上经得起检验。

为更好地发挥独立董事和外部董事的监督职能与参谋作用,

除例行召开股东会、董事会外，公司还定期安排实地走访和专题座谈。通过深入业务一线开展调研，独立董事和外部董事能够直观了解公司实际经营状况，为科学决策积累一手信息。专题座谈会则围绕市场动向、业务改善、人力资源配置及风险防控等重点议题展开讨论，有效提升了公司的战略统筹能力和管控水平。

2026 年上半年，公司各专门委员会有序运行，董事会审计委员会会议召开 3 次，提名委员会 3 次、战略与 ESG 委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次以及独立董事专门会议 1 次，充分发挥了专门委员会与独立董事的专业优势，持续优化公司治理结构，助力公司高质量发展。公司积极组织董事、高级管理人员参加上市公司协会、上海证券交易所等机构举办的董事、高管培训课程，强化“关键少数”履职能力建设。

展望未来，公司将持续关注法律法规及监管要求的变化，结合企业实际，强化精细化管理，完善制度体系，以规范的治理流程与有效的内部控制为保障，确保公司在稳健发展的道路上行稳致远。

五、提高信息披露质量与投资者沟通效能

公司高度重视信息披露工作，将严格遵循信息披露的真实性、准确性、完整性、时效性及公平性原则视为维护投资者利益、提升公司透明度的核心准则。为此，公司持续优化与投资者的沟通机制，采用多样化渠道与投资者保持高频次、高质量的互动交流。

自本年度行动方案实施以来，公司于上海证券交易所路演中心正式举办了2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会（已于2026年5月召开）。会议期间，公司管理层与投资者就经营成果、财务状况等关键议题进行了深入交流，及时回应投资者关切，有效增强了投资者对公司发展的信心与理解。

在信息披露日常工作中，公司充分利用上海证券交易所e互动平台、电话、电子邮件等多元化沟通渠道，确保与投资者的沟通畅通无阻。通过定期发布信息、及时回应询问等方式，帮助投资者全面了解公司业务、文化以及战略规划，进一步巩固投资者对公司的信任与认同。

展望未来，公司将继续秉持高质量发展与规范治理的理念，全面提升公司治理与管理水平。公司将以良好的业绩表现、规范的公司治理以及积极的投资者回报，切实履行上市公司责任与义务，以实际行动回馈投资者的信任，维护公司良好市场形象，共同推动资本市场平稳健康运行，为投资者创造更多价值。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年8月27日